



Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoża nienasiąkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoża budowlanych.

Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej.

Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni.

Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całościowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% \geq 40 \%$$

$P_e$  - efektywna powierzchnia przyklejenia płyty termoizolacyjnej do podłoża

$P$  - powierzchnia płyty termoizolacyjnej przylegająca do ściany

**BM art Projekt**

Kielce ul. Starodomaszowska 30/53 tel./fax 344-81-14

**Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania w budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29**

Branża	Architektura - projekt wykonawczy			Numer rysunku
Przedmiot rysunku	Sposób klejenia płyt styropianowych			<b>A-17</b>
Investor	<b>Gmina Stryków, ul. Kościuszki 27 96-010 Stryków</b>			Skala rysunku
Adres budowy	<b>Stryków, ul. Kościuszki 29 dz. nr 436, 437, 438 i 439/2</b>			<b>1:10</b>
Projektował	mgr inż. arch. Przemysław Dziewierz	nr upr. SW-36/2007	Data 12.2008	Podpis
Opracował	mgr inż. Mateusz Rolecki	-----	Data 12.2008	Podpis